

RL78/G10 グループ半田付け条件判定表

RL78/G10GROUP”SOLDERING CONDITIONS TABLE”

R01ZZ0093XJ0200_RL78G10_JE

パッケージ名 Package	型名 Part Number	リフロ条件 INFRARED REFLOW RDK-J-000312(JP) (旧番号:SSD-A-M5658-2)(JP) RDK-J-000318-2(EN) (旧番号:SSD-A-M5659-1)(EN)	ウエーブソルダリング条件 WAVE SOLDERING RDK-J-000313(JP) (旧番号:SSD-A-M5660-3)(JP) RDK-J-000319-2(EN) (旧番号:SSD-A-M5661-1)(EN)	部分加熱条件 RDK-J-000314-2(JP,EN) (旧番号:SSD-A-M5662-1)(JP) (旧番号:SSD-A-M5663)(EN)
10ピン Plastic LSSOP (4.4×3.6mm)	R5F10Y1xASP	○	○	○
	R5F10Y1xDSP	○	○	○
16ピン Plastic SSOP (4.4×5.0mm)	R5F10Y4xASP	○	○	○
	R5F10Y4xDSP	○	○	○

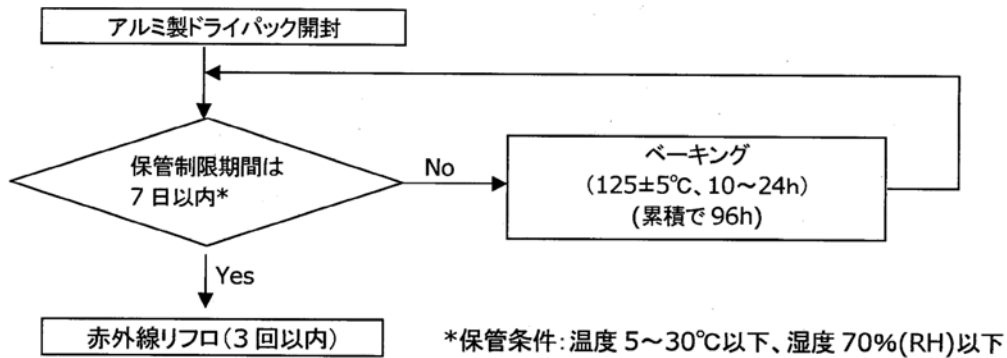
実装条件
赤外線リフロ方式のはんだ付け推奨条件
[温風、赤外線、温風リフロを含む]
吸湿量管理品

MSL3

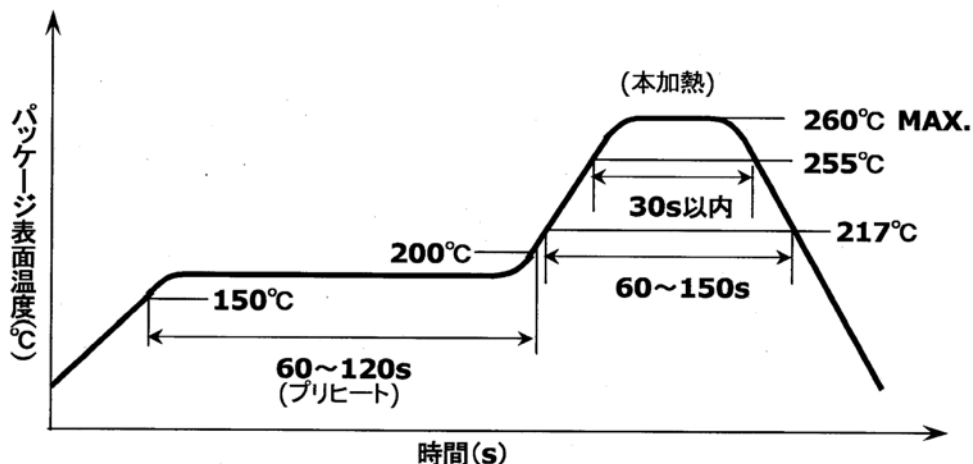
RDK-J-000312 1/1

ルネサス エレクトロニクス株式会社
Renesas Electronics Corporation

赤外線リフロ方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。



- ピーク温度(260℃の場合) : 260℃MAX
- ピーク温度(-5℃)の時間 : 255℃ 30s 以内
- はんだ融点以上(217℃以上の時間) : 60~150s
- プリヒート領域(150~200℃の時間) : 60~120s
- 最多リフロ回数 : 3回
- ドライパック開封後の保管制限期間 : 7日以内



<赤外線リフロ温度プロフィール>

留意事項

- ✓ 耐熱トレイ以外(マガジン、テーピング、非耐熱トレイ)は包装状態でのベーキングができません。
- ✓ インジケータの 30%検湿部が、ラベンダー色 又は ピンク色に変化していた場合は、ベーキングを推奨致します。
- ✓ はんだ溶融温度は使用される基板やペースト材料で異なりますので、実装温度プロフィールについては、本提示条件以下で最適温度をご確認の上、ご使用をお願いいたします。

Mount Conditions
RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS
OF INFRARED REFLOW

[INCLUDING CONVECTION, INFRARED/CONVECTION]

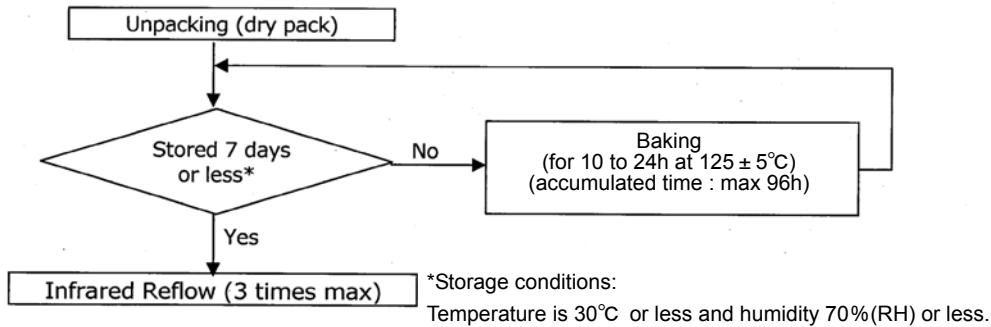
Moisture sensitive device

MSL3

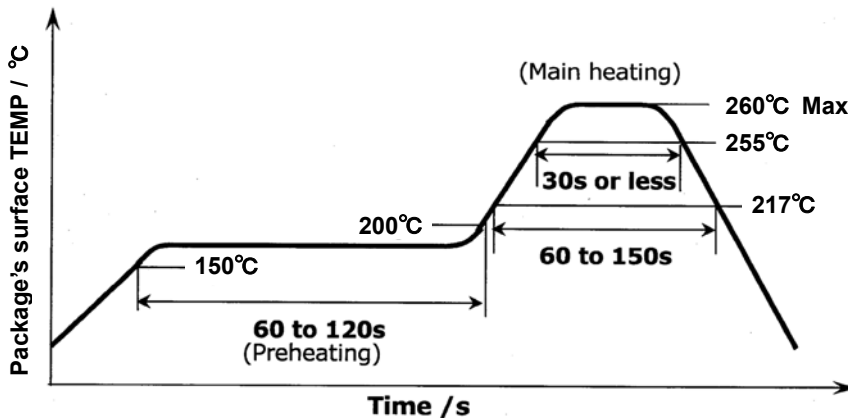
RDK-J-000318-2 1/1

Renesas Electronics Corporation

The following is recommended soldering conditions of infrared reflow.



Maximum temperature (Package's surface TEMP)	:260°C or below
Maximum time for temperature higher than 255°C	:30s or less
Time for temperature higher than 217°C	:60 to 150s
Preheating time (150 to 200°C)	:60 to 120s
Maximum number of reflow processes	:3 times
Keeping limitation period after opening dry pack	:7 days or less



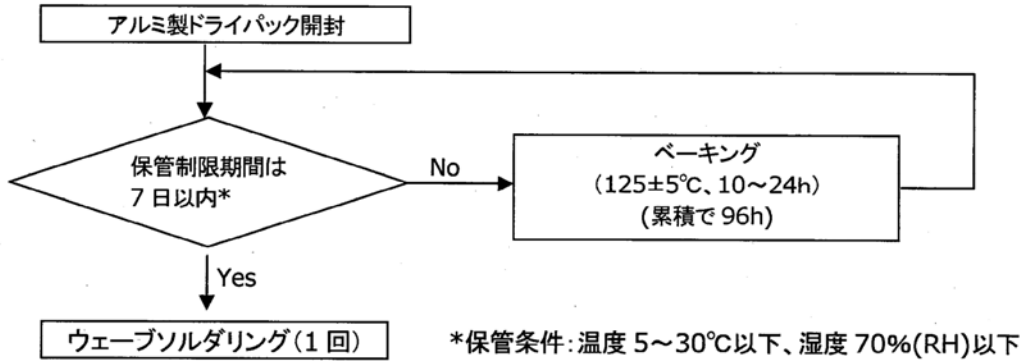
<Infrared Reflow Temperature Profile>

Notice

- ✓ For baking components, it is necessary to use heatproof type container. Plastic magazines, emboss tape/reels and some of trays are not heatproof type, so if the packing container is not heatproof type, please transfer them to a heatproof type container
- ✓ When the color of the humidity detection mark of 30% of the indicator has been changed into lavender or pink, it is recommended to execute the baking.
- ✓ Since solder melting temperatures differ with a substrate or the material of paste, please confirm the optimal temperature in the condition shown above before using components.

<p style="text-align: center;">実装条件</p> <p style="text-align: center;">ウェーブソルダリング方式のはんだ付け推奨条件</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">吸湿量管理品</div> <p style="text-align: right;">MSL3</p>	RDK-J-000313 1/1
	<p>ルネサス エレクトロニクス株式会社</p> <p>Renesas Electronics Corporation</p>

ウェーブソルダリング方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。



- ピーク温度(はんだ温度) : 260°C以下
- ピーク温度の時間(一次+二次噴流通過時間) : 10s 以内
- 回数 : 1 回
- プリヒート温度(PKG 表面温度) : 120°C MAX
- プリヒート時間 : 制限無し

留意事項

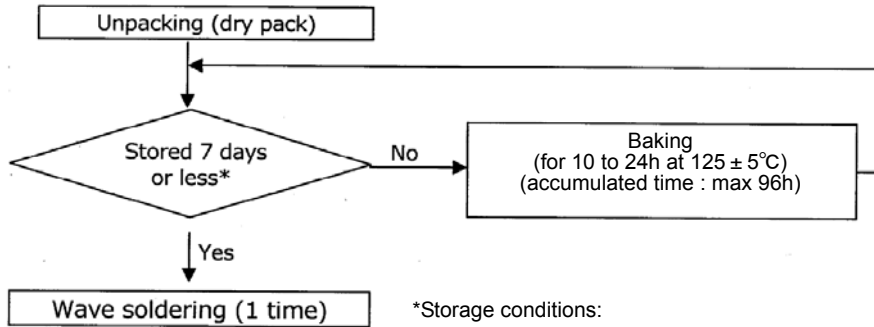
- ✓ 耐熱トレイ以外(マガジン、テーピング、非耐熱トレイ)は包装状態でのベーキングができません。
- ✓ インジケータの 30% 検湿部が、ラベンダー色 又は ピンク色に変化していた場合は、ベーキングを推奨致します。
- ✓ はんだ溶融温度は使用される基板やペースト材料で異なりますので、実装温度プロファイルについては、本提示条件以下で最適温度をご確認の上、ご使用お願いいたします。

Mount Conditions
RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS
OF WAVE SOLDERING
Moisture sensitive device

RDK-J-000319-2 1/1

Renesas Electronics Corporation

The following is recommended soldering conditions of wave soldering.



*Storage conditions:
Temperature is 30°C or less and humidity 70%(RH) or less.

Maximum temperature (Solder temperature)	:260°C or below
Time at maximum temperature	:10s or less
Maximum number of flow processes	:1 time
Maximum preheating temperature (Product's surface temp.)	:120°C or below
Maximum preheating time	:No limitation

Notice

- ✓ For baking components, it is necessary to use heatproof type container. Plastic magazines, emboss tape/reels and some of trays are not heatproof type, so if the packing container is not heatproof type, please transfer them to a heatproof type container.
- ✓ When the color of the humidity detection mark of 30% of the indicator has been changed into lavender or pink, it is recommended to execute the baking.
- ✓ Since solder melting temperatures differ with a substrate or the material of paste, please confirm the optimal temperature in the condition shown above before using components.

実装条件 部分加熱方式のはんだ付け推奨条件 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">表面実装部品</div> Mount Conditions RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS OF PARTIAL HEATING <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Surface mount device</div>	RDK-J-000314-2 1/1
	ルネサス エレクトロニクス株式会社 Renesas Electronics Corporation

部分加熱方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。

- 最高温度(端子温度) : 350°C以下
- 時間(パッケージの一边あたり) : 3s 以内
- 最多回数 : 1 回

The following is recommended soldering conditions of partial heating.

- Maximum temperature (Pin temperature) : 350°C or below
- Time (per side of the device) : 3s or less
- Maximum number of heating processes : 1time